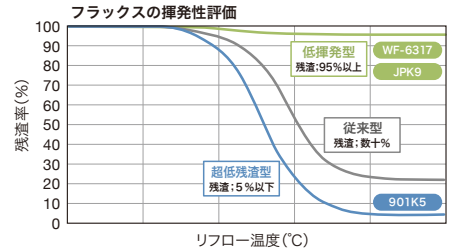


### 優れた有機合成技術で半導体パッケージングをサポート

Supports semiconductor packaging with a superior organic synthesis technology

#### 特長

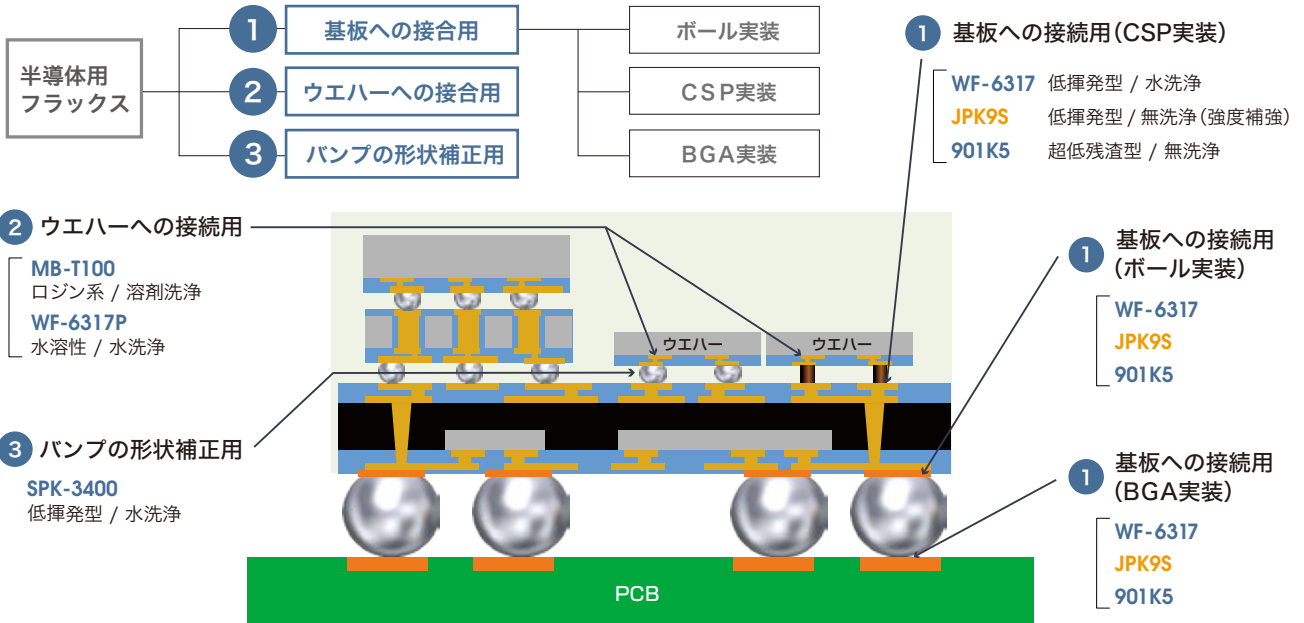
- 高活性タイプで高耐熱性の水溶性フラックスWF-6317
- 低揮発性によりリフロー炉の汚染を抑制可能なWF-6317
- フラックス残渣が熱硬化性樹脂で接合を補強するJPK9S
- リフローで95%以上のフラックスが揮発、無洗浄可能な901K5



#### Revolutionary Products

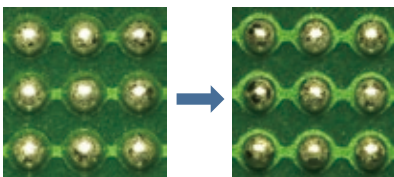
### 用途や目的に応じて、はんだ付けに効果的なフラックスを選択

用途や目的に応じて、はんだ付けに効果的な製品をお選びください



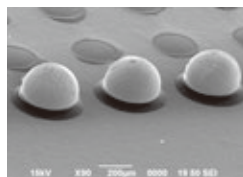
### ● ソルダボール、CSP、BGAを基板に実装する時に用いる半導体用フラックス

温水洗浄でフラックス残渣ゼロ



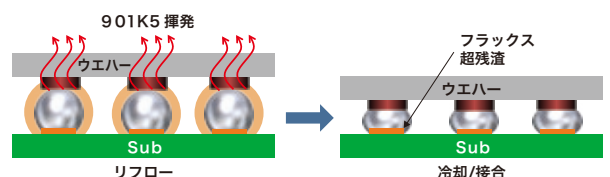
低揮発・水洗浄タイプのWF-6317

フラックス残渣が接合を補強



低揮発・無洗浄タイプのJPK9S

リフロー中にフラックスが揮発



超低残渣・無洗浄タイプの901K5